

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20220506

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	通过“劲拓股份投资者关系”微信小程序参与 2021 年度业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 6 日
地点	“劲拓股份投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 徐德勇 董事兼副总经理 何元伟 董事 陈东 董事 徐尧 财务负责人 邵书利 副总经理兼董事会秘书 张娜 独立董事 何晴 独立董事 吴易明 独立董事 彭俊彪
投资者关系活动主要内容介绍	一、2021 年营收和净利同比下跌的主要原因是什么 副总经理兼董事会秘书 张娜：尊敬的投资者您好！ 2021 年度公司营业收入约 9.89 亿元，同比上年增加约 1 亿元。

2021 年度归属于上市公司股东的净利润约 8,000 万元，同比下降约 4,280 万元，主要原因为：1、原控股孙公司业绩亏损，导致公司合并报表业绩减少约 1,650 万元，该公司偿债能力变弱，导致公司应收款项全额计提坏账准备约 1,000 万元，合计减少业绩约 2,650 万元；2、2021 年计提的股份支付费用较 2020 年增加约 1,370 万元；3、2021 年新厂装修的在建工程转计入固定资产，折旧费用同比上年增加约 1,070 万元；4、部分上游原材料价格上涨导致生产成本承压，加之公司与部分客户签订的毛利较低的战略订单在本期验收，拉低了当期毛利；5、公司为聚焦主业、腾挪发展空间，清理业务条线，打折销售了部分库存设备，对本期毛利率也产生了一定影响；6、公司持续加大投入相关国产高端电子热工设备、国产半导体设备等的研发和市场开拓，相关投入“吃掉”不少当期利润。

公司 2021 年度营收增加及归属于上市公司股东的净利润减少的详细情况，建议您查阅公司已公开披露《2021 年度报告》，谢谢！

二、公司股价近期一直处在下跌趋势中，除了受大环境的影响之外，还有其他哪些因素导致的

董事 徐尧：您好，公司股价受到多方面因素影响，除了受经济环境、货币政策、国际形势、地缘政治等大环境影响外，投资者情绪也是非常重要的影响因素，因此公司在今年充分考虑各项因素的情况下，实施了总额 1.2 亿元的现金分红，就是为了用真金白银回馈投资者，提升投资者长期持股的信心，谢谢！

三、现阶段半导体设备公司在手订单情况怎么样？

财务负责人 邵书利：您好！截止 2022 年第一季度报告披露日，公司半导体在手订单占总体订单比例为 5%左右，随着

半导体设备的陆续验收及市场需求的增加，后续半导体设备市场前景可期，谢谢！

四、近期人民币贬值，是否对公司的出口业务有影响

副总经理兼董事会秘书 张娜：尊敬的投资者您好！我司出口业务主要以美元结算，人民币贬值对出口业务有一定积极影响，但是我司出口业务不多，2021年度外销业务营收占比仅 4.17%，感谢您的关注！

五、未来公司业绩增长的驱动力主要集中在哪里

副总经理兼董事会秘书 张娜：尊敬的投资者，您好！

公司长期专注于电子热工设备领域，为国家工信部认定的制造业单项冠军产品企业，电子热工设备的市场份额、技术实力、产品质量和品牌知名度，一直走在国内前列，未来会继续巩固和提升市场领先优势。

公司在专注手机显示领域的同时，将光电产品应用领域逐步延伸至车载显示、硅基 OLED 显示、可穿戴类显示等领域，积累资源为光电业务增能蓄力。

在全球半导体制造产能持续紧张背景下，近年来半导体设备市场发展迅速，半导体设备投资支出持续增加，伴随着半导体行业资本开支持续拔高，半导体设备行业景气度有望不断提升，公司积极抓住半导体设备国产化的产业发展机会，公司经过前期缜密且审慎的市场研判，结合公司自身优势特点，确定了国产半导体封装和硅片制造设备领域为公司新的战略增长点。谢谢！

六、公司的在建工程项目目前主要有哪些，预计什么时候可以投产

财务负责人 邵书利：您好！公司目前无在建工程项目，在建工程项目均已投产使用。谢谢！

七、请问公司目前在手订单 4 亿，有多少是半导体订单

董事长兼总经理 徐德勇：您好！据统计占比约 5%左右，我司设立了控股孙公司思立康及至元发展半导体业务，后续订单转化为收入的情况，建议关注公司后续公告并以公告内容为准，谢谢！

八、徐总您是如何看待装备制造业的发展前景和市场潜力的？

董事长兼总经理 徐德勇：您好，近年来，国家发布了《战略性新兴产业分类（2018）》、《2019 年政府工作报告》、《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》、《“十四五”智能制造发展规划》等多项政策文件，支持加快智能装备制造业的发展。随着国家对于精密装备制造产业的大力政策扶持，行业发展迅猛，目前在对速度和精度要求都极为严格的高尖端应用中，德国、美国和日本等发达国家仍占据主导地位，未来随着重点领域突破，各项专业技术不断提升，高尖端市场该类设备的国产率会不断提升。谢谢！

九、公司是否存在利用计提财务洗澡？

财务负责人 邵书利：尊敬的投资者您好，财政部发布的《企业会计准则》对于会计信息质量要求、财务会计报表要素、会计计量、财务会计报告等都作出了明确的要求。实施财务数据操纵或财务洗澡行为，本质上也是严重的财务造假行为。既违反了《企业会计准则》的规定，也有违上市公司信息披露的基本要求，更严重违反了《证券法》等法律法规。公司严格遵守相关规定，不存在利用年报计提实施财务洗澡行为！谢谢您！

十、未来研发费用投入计划是怎样的，可以分几块业务详细

讲一下吗

财务负责人 邵书利：尊敬的投资者您好，公司未来将会持续加大研发费用的投入，研发资源向半导体专用设备方向倾斜，谢谢！

十一、请问半导体硅片制造设备是用于什么工艺！是俗称的固晶机吗？

董事长兼总经理 徐德勇：您好！不是固晶机，我司设立了控股孙公司至元发展半导体硅片制造设备业务，因该产品受到严格的保密条约限制，为避免引起国外竞争对手的关注和打压，现阶段不便公开产品工艺，感谢理解！

十二、公司在积极拓展海外市场上做了哪些努力，成效如何？

董事长兼总经理 徐德勇：您好！我司产品市场主要集中在国内，出口业务占比不高。在海外市场方面：通过成立海外办事处、海外孙公司等方式拓展当地市场。我司越南办事处已成立、印度孙公司正在备案中，疫情影响了设立进度；同时成立海外销售部，提升直销收入占比，谢谢！

十三、请问董事长，公司已经很久没有机构上门调研，是否有与机构沟通的计划？维护股价

董事长兼总经理 徐德勇：您好，公司坚持努力提升经营业绩和企业价值，会逐步加大与资本市场的沟通力度，有效传递公司的投资价值。广大投资者可通过实地调研、线上交流、互动易等多种方式积极与公司进行交流。谢谢！

十四、近期的疫情有对生产经营有影响吗

副总经理兼董事会秘书 张娜：尊敬的投资者，您好！

本年初国内疫情零星散发和局部聚集性疫情交织叠加，对人

员流动、生产和物流造成了干扰，影响企业正常生产经营，应政府疫情防控要求，公司及客户复工复产进度亦不尽相同。疫情影响了部分客户正常的生产经营：①导致公司部分已发货产品验收进度缓慢；②导致部分交付设备无法如期安装调试；③导致部分客户要求延期交付等。疫情也导致了公司员工节后正常返岗受阻，生产备料、出货亦阶段性受到干扰，影响公司订单交付进度。

目前公司生产厂区所在地疫情已得到有效控制，公司日常生产已恢复。随着其他区域疫情的缓解，我们相信公司客户及供应商的生产经营会逐步回归正轨，谢谢！

十五、如何应对原材料价格上涨的风险

副总经理兼董事会秘书 张娜：您好，为应对上游原材料价格上涨，公司加强供应链管理，采取了多项措施降低原材料价格上涨向公司产品成本的传导：公司与主要供应商建立了长期战略合作关系，同时凭借公司领先的行业地位，保持外购标准件采购价格平稳；根据订单情况和对原材料行情分析，提前储备原材料，锁定价格，延缓了钢材等原材料价格上涨；改进工艺，降低部分原材料的加工成本；对供应商进行整合，将同类原材料集中在少数优质供应商采购，以数量优势降低供应商单位生产成本和公司采购价格；建立研发部门与采购部门联动机制，后期的工作早期介入，在产品研发设计方案阶段通过采购招标选择合适、高性价比的整体更优方案，在产品设计端降低原材料采购成本。谢谢！

十六、2021年公司在产品研发，客户培育，销售体量等方面取得了哪些成绩

董事长兼总经理 徐德勇：您好！

1、产品研发方面：（1）电子热工设备：推动回流焊、波峰焊、选择焊等系列产品结构升级，自主研发生产的真空回流

焊、高端无铅热风回流焊、隧道式氮气波峰焊和 NIS 系列选择焊等中高端产品获得客户认可和采购，并将应用范围延伸至 Mini LED、新能源 IGBT 模块、储能产品、充电桩大功率电源主板、车载控制板及 LED、高端汽车电子产品等多个新的应用领域；(2) 光电显示设备：应用领域覆盖至 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域；(3) 半导体专用设备：将自身热工方面的技术积累扩展至半导体专用设备领域，研制出一系列半导体热工设备（如半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、甩胶机、氮气烤箱等），引入较成熟的研发团队，结合自身较强的生产制造能力，成功在半导体硅片制造设备领域实现技术突破，并得到客户认可。

2、客户培育方面：经过多年经营，公司拥有一批稳定的客户群体，累计服务客户 4,000 余家。相关半导体集成电路厂家客户已拓展 10 数家。

3、销售体量方面：2021 年度公司实现营业总收入约 9.89 亿元，收入规模再创新高。谢谢！

十七、是否有采取一些套保措施来应对汇率波动的风险

财务负责人 邵书利：尊敬的投资者您好，因公司目前外销业务相对较少，暂未采取套保措施来应对汇率波动的风险。谢谢！

十八、请问徐董事为公司提供何种服务？

董事 徐尧：您好！本人加入公司董事会之后，从公司治理，合规运作、战略规划等方面为公司提供咨询和支持，谢谢！

十九、请问董事长，去年为稳定投资者，几个高管带头增持了股份，增持股价 20 元。目前公司股价 13 元，最低跌到 11 元多，请问公司的业务和基本面有改变吗？当初 20 元增持

的高管，今年还会对公司有信心继续增持吗？或者公司会不会回购股份作为新一期股权激励？

董事长兼总经理 徐德勇：您好，公司生产经营正常，业务和基本面未发生重大变化，公司管理层对公司未来充满信心，始终贯彻发展战略，努力提高经营业绩，后续如涉及增持计划或回购股份计划，公司会及时公告，谢谢！

二十、目前海外市场的需求情况怎样

董事兼副总经理 何元伟：您好，公司目前海外市场需求较去年同期有所降低，公司通过成立海外办事处、海外孙公司等方式拓展当地市场，努力提升海外市场销售规模，谢谢！

二十一、22年打算投入多少研发费用在半导体设备领域

财务负责人 邵书利：尊敬的投资者您好，持续的研发投入是公司保持竞争力的有力保障，公司将根据市场情况进行半导体设备领域研发的投入。谢谢！

二十二、公司未来的发展战略是什么？

董事长兼总经理 徐德勇：您好，公司专注于装备制造领域，坚持以客户需求为导向，以自主创新研发为动力，以电子热工设备为基石，完成了多款国产化半导体制造专用设备的研发、销售及产品定型，公司将继续凝聚资源加大对半导体先进设备的投入，从电子制造、光电显示领域将产业链延伸至半导体产业链，为相关行业提供高效、高精密度、可靠性强的国产化专用设备，力争成为更多细分领域的“单项冠军”或“隐形冠军”。谢谢！

二十三、请问公司采取了哪些措施进行成本优化

财务负责人 邵书利：尊敬的投资者您好，公司将从加强供应链管理，控制原材料成本；合理统筹生产管理，改进工艺

	<p>流程，持续落实精益化生产；提高服务质量，加快服务响应速度；调整公司组织结构，强化目标责任管理等多方面进行成本优化。谢谢！</p> <p>业绩说明会过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	--
日期	2022年5月6日